



三井金属

2021年6月23日

各 位

パッケージ基板用キャリア付極薄銅箔の生産体制を增強

～ 上尾事業所の生産能力を月産 200 万㎡へ ～

当社（社長 納武士）は、パッケージ基板用キャリア付極薄銅箔について、上尾事業所（埼玉県上尾市）の生産能力を 50 万㎡増強し月産 200 万㎡としたことをご知らせいたします。

当社のキャリア付極薄銅箔「MicroThin™」は、微細回路形成に適した 1.5 μm～5 μm の銅箔厚みと複数種類の微細な粗化処理を組み合わせた製品であり、主にパッケージ基板、スマートフォン用マザーボード（HDI プリント基板）に使用されております。

パッケージ基板用「MicroThin™」は、5G の本格的な普及に伴って需要が増加しており、今後も継続して需要が伸長していくものと考えております。

そのため、これまでパッケージ基板用「MicroThin™」は、主に上尾事業所から供給してまいりましたが、マレーシア工場（Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD.）への生産移管を順調に進めております。

一方、更なる高速通信用途にはファイン回路形成性と高周波特性に優れる「MT-GN」の量産を開始し（2020年4月22日プレスリリース）、お客様での採用が進んでおります。

今般の上尾事業所における生産能力の增強は、今後見込まれる「MT-GN」等のハイエンド製品の需要増に対応するためのものであり、スマート工場化および技術革新による生産性向上を図り、月産 150 万㎡から 200 万㎡への生産能力增強を実現致しました。

当社のスローガンである「マテリアルの知恵を活かす」のもと、安定した品質を維持し、お客様への十分な供給能力を確保してまいりますとともに、事業活動を通じ、サステナブル（持続可能）な社会作りに貢献します。

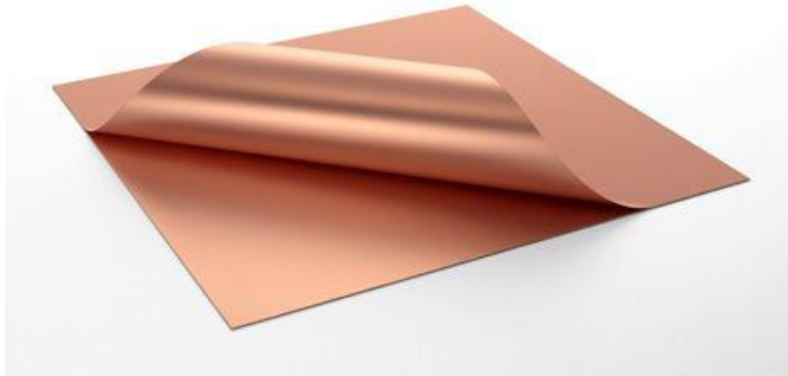
以上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL : 03-5437-8028 E メール : PR@mitsui-kinzoku.com

「MicroThin™」写真



上部：キャリア銅箔（厚み 18 μ m、12 μ m）

下部：極薄銅箔（厚み 1.5 μ m～5 μ m）

<ご参考> SDGs(持続可能な開発目標)との関連

SDGsは2015年9月に国連加盟国の総会決議により採択された、2030年までの17の開発目標です。今回の銅箔事業での活動はSDGsの下記項目に関連しています。

3 すべての人に健康と福祉を

9 産業と技術革新の基盤を作ろう

当社はSDGsの目標達成に向け貢献してまいります。